

株式の状況 (平成20年3月31日現在)

株式数及び株主数

発行可能株式総数	78,000株
発行済株式総数	19,500株
株主数	841名

大株主

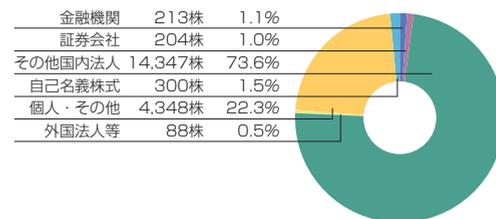
	持株数	持株比率
株式会社アルゴグラフィックス	9,900株	50.8%
セイコーインスツル株式会社	4,080株	20.9%
ジーダット従業員持株会	819株	4.2%
日本証券金融株式会社	154株	0.8%
石橋 真一	150株	0.8%
株式会社エスケーエレクトロニクス	90株	0.5%
株式会社図研	90株	0.5%
大日本印刷株式会社	90株	0.5%
凸版印刷株式会社	90株	0.5%

株主メモ

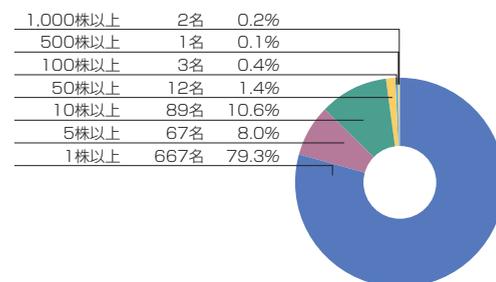
上場市場	JASDAQ
事業年度	4月1日から翌年3月31日まで
定期株主総会	毎年6月
基準日	3月31日
株式の売買単位	1株
株主名簿管理人	東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社
同事務取扱場所	東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
同取次所	みずほ信託銀行株式会社 全国各支店 みずほインベスターズ証券株式会社 本店及び全国各支店
公告掲載方法	電子公告とし、次の当社ホームページに掲載します。 (http://www.jedat.co.jp/) ただし、事故その他やむを得ない事由により、電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。

表紙の絵は、新旧の日本橋の様子です。
かつて、お江戸日本橋が物流の基点であったように、JEDATも、日本橋から日本EDAの最先端技術を世界に発信し続けます。

所有者別株式の状況



所有数別株主の状況



株式会社ジーダット

第6期

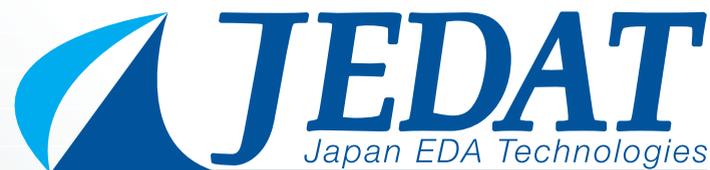


事業報告書

自平成19年4月1日 至平成20年3月31日



証券コード：3841



JEDAT は
Japan EDA Technologies の略です。
私たちは、日本のEDAのリーダーとして、
電子産業の発展に貢献したいと考えています。

EDA とは
Electronic Design Automation の略です。

電子機器や電子部品の設計作業を支援、検証するソフトウェア（電子系CAD）で、
設計作業には不可欠なツールであり、設計期間の短縮や設計品質の向上を実現します。

CONTENTS

株主の皆様へ.....	2	業績の概要.....	5	連結財務諸表.....	7
トピックス.....	9	シリーズ ジーダットの設計ツール.....	9		
会社概要/役員.....	10				

HP&IRサイトご紹介

URL <http://www.jedat.co.jp/>
IRサイト http://www.jedat.co.jp/ir_infor/index.html

当冊子に関するお問合せ先

株式会社ジーダット 経営企画部
E-mail : corporate.planning1@jedat.co.jp

株主の皆様へ



代表取締役社長
石橋 眞一

株主の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は当社企業グループに格別のご支援とご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

当第6期（自平成19年4月1日 至平成20年3月31日）は、予想を上回るFPD市場の投資抑制のため大変苦戦いたしましたが、下半期に半導体市場における受注が伸びたことから、前期に比べ増収増益となりました。

しかしながら、当社の顧客である半導体市場、FPD市場では、生産規模は伸びるも急速な単価下落のため収益が伴わない状況が続いており、業界再編の動きすら出てきております。このような予測の難しい状況の中で、当社はより一層の販売力強化を行うとともに、研究開発への着実な投資を継続して常に革新的な技術を追求め、成長へ繋げてまいり所存でございます。

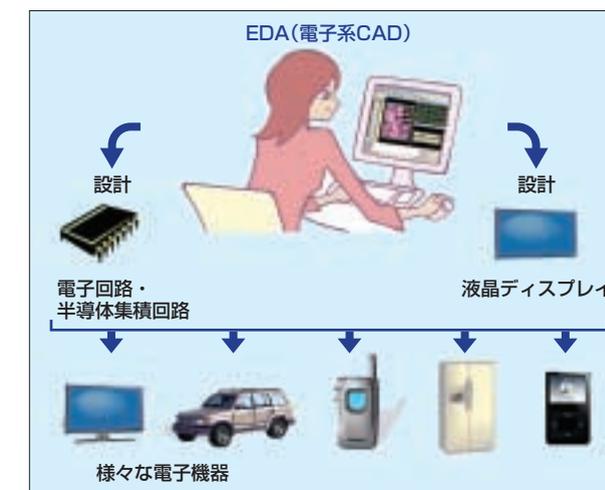
本事業報告書では、当社の事業をより深くご理解いただくために質問形式での解説を付載いたしました。株主の皆様により一層のご理解とご支援を賜りますよう、どうかよろしくお願い申し上げます。

平成20年6月

Q1. ジーダットの事業は私達の日常生活にどのように関わっていますか？

現在では携帯電話やパソコン等のIT機器だけではなく、冷蔵庫等の家電製品や自動車にも、多くの高性能な電子部品（電子回路や半導体集積回路、液晶ディスプレイ等）が使われています。これらの電子部品の設計に使われているのが、当社が開発・販売しているEDAソフトウェア（電子系CAD）であります。

当社は、国内大手の半導体や液晶等の電子部品メーカー、家電メーカー、自動車メーカー等に、世界レベルの最先端技術による自社開発製品を主力とした様々なEDAをご提供し、電子部品設計者の方々の立場に立ったコンサルテーションを行っております。



Q2. ジーダットの製品には、どのようなものがありますか？

当社がご提供しているEDA製品群の中核となるのは自社開発製品の「 α -SX」であります。「 α -SX」は、回路設計ツール「Asca」、レイアウト設計ツール「Ismo」をはじめとして、様々な検証ツール群、自動設計ツール群、液晶パネル等の微細パターン設計ツール群、マスク検証ツール群等から構成されております。

さらに、パートナー企業の製品を組み合わせることで、お客様に強力な設計環境をご提供しております。

主な製品		
	自社開発製品	代理販売製品
半導体向け	Asca 回路設計・デバッグ統合環境 Ismo 高機能レイアウト設計システム Amper 会話型高速素子配置ツール Rexsir 高密度自動配線ツール CMP-Designer CMPダミーパターン設計システム	Arsyn/Arana 回路最適化／解析ツール CharFlo-Memory! SRAM向けライブラリ自動生成環境 HiTas トランジスタレベル静的解析ツール Takumi Enhance/HSF ホットスポット自動解消ツール HOTSCOPE 超高速フォトマスクデータブラウザ
	FineArts FPD・微細加工用設計システム FineAcres 高精度抵抗計算 FineRFP レチクルフロアプランナ	PARADISEWORLD-2 断面形状シミュレータ ExpertLCD 3次元液晶シミュレータ

Q3. 競争力のある製品を開発するために、どのようなことをしていますか？

当社では競争力のある製品を開発してお客様にご提供するために、以下のことを実施しております。

◆高比率な研究開発投資

当社は高い製品競争力を保持するため、売上比2割前後の費用を継続的に研究開発費に充てております。

◆優秀な人材の確保

当社は世界で通用する製品開発を目指して、優秀な技術者をグローバルに採用しております。

◆積極的な技術提携

国内外の多くの大学との共同研究や、最新技術を保有する他社との技術提携により、最先端の製品開発をスピーディーに行っております。

◆お客様志向の開発体制

開発者がお客様を訪問して直接ご意見を聞くことやお客様の設計方式を研究することにより、開発者自らがニーズを掴み、製品開発にタイムリーに反映させております。

◆お客様の設計手法に合わせたサポート

当社製品をお客様の多岐にわたる設計手法の下で最適に使用して頂くため、経験豊富な技術陣による導入前のシステム提案から、お客様の設計フローの立ち上げ、運用開始後のコンサルテーションまで、強力なサポートを実施しております。

Q4. 日本の電子部品業界の景気動向や再編は、業績にどのような影響を与えますか？また、その対応策はどのように考えますか？

日本の液晶業界は、液晶パネルの価格下落の影響を受け、依然厳しい状況が続いております。設備投資の抑制が長引いた結果、当社の業績にも少なからず影響し、当期のFPD分野の売上は対前年同期比26.1%減となりました。このような業界の動向は今後とも続くものと思われま

す。当社製品は、国内液晶業界においてすでに高いシェアを有しておりますが、ユーザーニーズにより細かく対応していくことで、いっそうのシェア拡大を目指します。

また今後は、韓国・台湾・中国等の海外市場での売上拡大を加速するため、各国代理店の整備・強化をいっそう進めてまいります。

半導体業界は市場規模が大きく、一方当社のシェアはまだまだ限られているため、当社の業績は業界の景気動向に比較的左右されにくい状況にあります。

当社がフォーカスしているアナログLSI、液晶ドライバ、メモリ等のフルカスタムデザイン分野の設計自動化等の技術的な優位性をさらに伸ばし、また、新規市場であるDFM分野に向けて、さらなる売上拡大を図ってまいります。

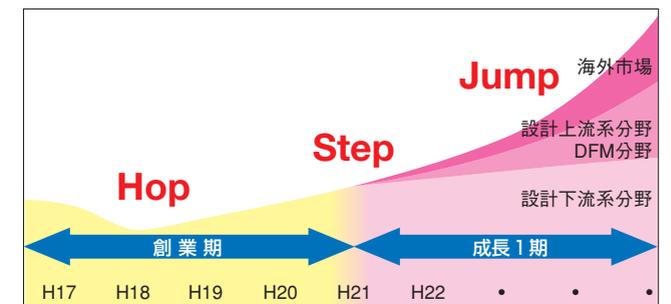
Q5. 平成21年3月期中に創立5周年を迎えますが、今後のビジョンについて教えてください。

当社は、営業を開始した平成16年3月期当初から、お客様に当社製品を安心して長く使っていただくため安定した財務基盤作りを進め、平成19年3月期にJASDAQに上場いたしました。

平成20年3月期からは、当社の得意分野である設計下流系分野（レイアウト設計）に加え、設計上流系分野（回路設計）及びDFM分野（製造考慮設計）へと事業を拡大しており、それらの分野に対する開発投資を重点的に行っております。

設計上流系分野では、回路設計・デバッグ環境の機能や使い勝手を大幅に向上させ、戦略的新製品を早期に投入する予定であり、またDFM分野では、自社開発製品の機能強化と、技術提携した製品による市場開拓を進めてまいります。

さらに平成20年3月期以降、海外向けの売上を伸ばしていくために、各国海外販売拠点の強化を行ってまいります。



業績の概要

2期連続で増収、増益

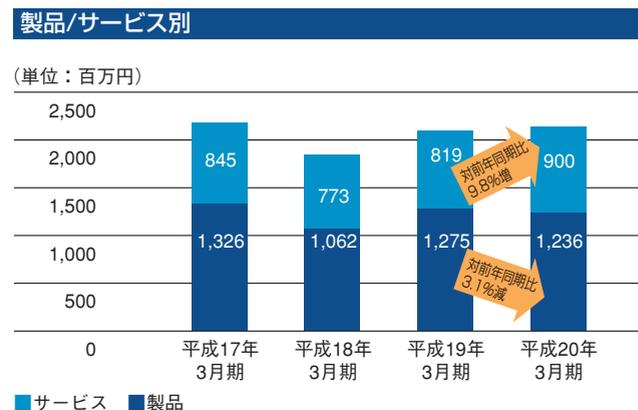
当社企業グループの主要な顧客である半導体ならびに液晶等の製造業は、円高や国際競争のあおりを受け、依然厳しい環境下にあります。特に液晶パネルの価格下落、在庫調整の影響等厳しい環境下にある液晶関連の製造業においては、全体的に前年度に比べ投資抑制の傾向が続いてまいりました。このような状況の中であって、当社企業グループの業績は比較的順調に推移して、2期連続の増収・増益となりました。

主な活動内容としては、主力製品である「α-SX」シリーズを中心にアナログLSIなどのフルカスタム設計分野向けの自動化機能の更なる強化を図ることによって、市場競争力の向上に努めました。さらに、今後の激しい技術革新に備えるべく、最先端技術の研究開発も継続的に実施いたしました。このような製品力、技術力を背景に、各顧客企業が抱える様々な課題を解決すべく、顧客の設計現場に密着して提案を重ねていくことで、増設商談の獲得、保守契約の早期締結・更新を推し進めてまいりました。

また、液晶等の高精度FPD(Flat Panel Display)分野を中心に海外顧客への積極的な提案を行うことで市場の拡大に努め、DFM(Design For Manufacturability)・マスク検証分野では米国Takumi社との業務提携をスタートいたしました。

た。さらに、平成19年7月25日に当社100%出資の株式会社A-ソリューションを設立し、今後IP(Intellectual Property: LSIを構成するために必要な機能ブロック等の設計資産)事業へも進出し、当社企業グループの中長期的な事業拡大のための礎作りにも積極的な投資を行ってまいりました。

以上の結果、当連結会計年度における連結売上高は、前連結会計年度より増収となり、連結売上高経常利益率は13.8%となりました。当連結会計年度の連結売上高は、21億36百万円(前年同期比2.0%増)、連結営業利益は2億21百万円(前年同期比7.1%増)、連結経常利益は2億94百万円(前年同期比1.3%増)、連結当期純利益は1億97百万円(前年同期比4.5%増)と増収、増益となりました。



半導体向け売上は23.1%増、FPD向け売上は26.1%減

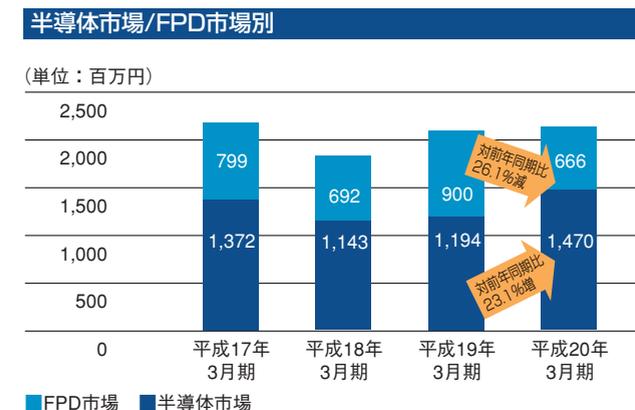
当連結会計年度における当社企業グループの売上高は、製品及び商品売上高は12億36百万円(前年同期比3.1%減)、サービス売上高は9億円(前年同期比9.8%増)となりました。

製品及び商品売上高は、主力製品「α-SX」シリーズの市場競争力が向上したことで、半導体市場を中心に増設ならびに新規顧客開拓が進みましたが、FPD市場の落ち込みをカバーするまでにはいたりませんでした。サービス売上は、保守契約の更新が順調に進み売上に貢献いたしました。

半導体市場、FPD市場の区分別でみると、半導体市場においては「α-SX」製品の既存顧客を中心とした増設ならびに保守契約の締結による安定した売上に加えて、新規顧客の開拓、DFM

分野のブラウザであるHOTSCOPE製品の拡販等で、14億70百万円(前年同期比23.1%増)となりました。液晶等のFPD市場につきましては、一部顧客の投資抑制の影響を受けた他、中国、韓国等の海外市場の新規開拓が計画通りに進捗しなかったこともあり、6億66百万円(前年同期比26.1%減)となりました。

自社開発製品、代理販売製品の区分でみると、自社開発製品による売上高は18億34百万円(前年同期比2.8%増)、代理販売製品による売上高は3億1百万円(前年同期比3.0%減)となりました。



連結財務諸表

(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

連結貸借対照表

			(単位:千円)		
科目	当連結会計年度 (平成20年3月31日)	前連結会計年度 (平成19年3月31日)	科目	当連結会計年度 (平成20年3月31日)	前連結会計年度 (平成19年3月31日)
資産の部			負債の部		
流動資産	① 1,894,038	2,488,051	流動負債	561,081	502,825
現金及び預金	1,348,367	1,917,379	買掛金	148,788	138,798
受取手形及び売掛金	421,216	481,186	未払法人税等	115,204	101,965
たな卸資産	27,965	17,104	賞与引当金	87,790	82,359
繰延税金資産	56,056	42,527	その他	209,298	179,701
その他	45,232	29,854	負債合計	561,081	502,825
貸倒引当金	△4,800	—			
固定資産	② 1,076,873	310,576	純資産の部		
有形固定資産	24,845	21,364	株主資本	2,428,836	2,293,304
無形固定資産	8,252	78,477	資本金	760,007	760,007
のれん	—	71,800	資本剰余金	890,558	890,558
ソフトウェア	8,252	6,677	利益剰余金	810,948	642,738
投資その他の資産	1,043,775	210,733	自己株式	△32,676	—
投資有価証券	100,200	—	評価・換算差額等	△19,007	2,497
長期貸付金	5,902	8,250	その他有価証券評価差額金	△21,740	—
繰延税金資産	181,926	146,310	為替換算調整勘定	2,732	2,497
長期性預金	700,000	—	純資産合計	2,409,829	2,295,802
その他	55,746	56,172	負債純資産合計	2,970,911	2,798,627
資産合計	2,970,911	2,798,627			

① 流動資産

流動資産の減少は、主に現金及び預金のうち7億円を長期性預金へ預入れしたことによるものであります。

② 固定資産

無形固定資産の減少は、のれんの償却71百万円、投資その他の資産の増加は、流動資産から長期性預金への預入れ7億円及びTakumi Technology Corp. への投資1億円によるものであります。

連結損益計算書

			(単位:千円)	
科目	当連結会計年度 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)	前連結会計年度 (自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)		
売上高	2,136,528	2,095,540		
売上原価	658,381	622,047		
売上総利益	1,478,147	1,473,492		
販売費及び一般管理費	1,256,234	1,266,267		
営業利益	221,912	207,225		
営業外収益	75,830	95,680		
営業外費用	2,989	11,914		
経常利益	294,753	290,991		
税金等調整前当期純利益	294,753	290,991		
法人税、住民税及び事業税	146,438	145,276		
法人税等調整額	△49,144	△43,302		
当期純利益	197,459	189,016		

連結株主資本等変動計算書

	株主資本					評価・換算差額等			純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計	その他有価証券 評価差額金	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等合計	
平成19年3月31日残高	760,007	890,558	642,738	—	2,293,304	—	2,497	2,497	2,295,802
連結会計年度中の変動額									
剰余金の配当			△29,250		△29,250				△29,250
当期純利益			197,459		197,459				197,459
自己株式の取得				△32,676	△32,676				△32,676
株主資本以外の項目の 連結会計年度中の変動額(純額)						△21,740	234	△21,505	△21,505
連結会計年度中の変動額合計	—	—	168,209	△32,676	135,532	△21,740	234	△21,505	114,027
平成20年3月31日残高	760,007	890,558	810,948	△32,676	2,428,836	△21,740	2,732	△19,007	2,409,829

③ 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動の結果使用した資金は、投資有価証券の取得による支出1億21百万円及び長期性預金への預入れ7億円により、8億29百万円となりました。

連結キャッシュ・フロー計算書

			(単位:千円)	
科目	当連結会計年度 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)	前連結会計年度 (自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)		
営業活動によるキャッシュ・フロー	322,483	319,032		
投資活動によるキャッシュ・フロー	③ △829,803	△24,977		
財務活動によるキャッシュ・フロー	④ △61,926	1,004,686		
現金及び現金同等物に係る換算差額	234	799		
現金及び現金同等物の増減額(減少△)	△569,011	1,299,540		
現金及び現金同等物の期首残高	1,917,379	617,838		
現金及び現金同等物の期末残高	1,348,367	1,917,379		

④ 財務活動によるキャッシュ・フロー

前連結会計年度が増資及び新株発行に伴い、10億4百万円の収入であったのに対し、当連結会計年度においては、配当金の支払い29百万円及び自己株式の取得による支出32百万円により、△61百万円となりました。

EDS Fair2008に出展、ブース来場者は過去最大数

当社は、2008年1月24日（木）、25日（金）の2日間、パシフィコ横浜で行われた、Electronic Design and Solution Fair 2008（EDS Fair2008）に出展いたしました。

今年、『 α -SXによる、カスタムデザインをターゲットとした設計TAT短縮：1/3の実現！』をメインテーマに、ステージプレゼンテーションとオープンデモンストレーションを行い、各社電子部品設計者の皆様方にジエダットの最新技術に触れていただきました。

主力製品 α -SXをはじめ、Takumi社製品等のDFM・マスク向け製品、2007年7月に設立した当社子会社のA-ソリューションが扱うアナログIPの他、回路合成・回路検証・ライブラリ生成ツール、RTL解析・検証ツールともにご好評をいただき、EDSFairにおけるジエダットブースの来場者数は、過去最高数を記録いたしました。



シリーズ ジエダットの設計ツール

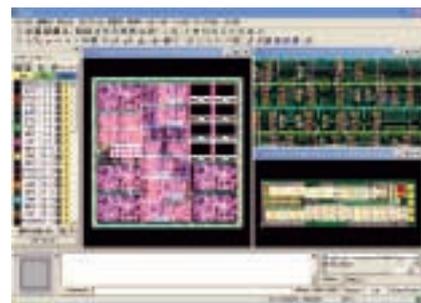
Ismo (イズモ)

～「Ismo」の由来～
日本古来の地、出雲（いずも）と、英語の「Gismo/Gizmo」（ギズモ）＝（巧妙な仕掛け、賢い道具）を掛け合わせている。日本古来の匠の技術と、欧米の洗練された先進技術との融合といった意味合い。

～レイアウト設計・デバッグ統合環境～

「 α -SX」シリーズのコアとなる、LSIやLCDパネル等の微細加工部品のレイアウトパターン/マスク設計を支援する高機能グラフィックエディタです。「Ismo」を使用することによって、回路図の結線情報や制約条件、及び製造プロセス

ルールを守りながら、トランジスタや抵抗等の各種素子の配置及び配線を正しくかつ素早く行うことができます。



半導体の高集積化、高速化により、レイアウト設計環境においても、より大規模な設計データに対応しかつ強力な設計環境が必要とされるようになってまいりました。また、半導体の多用途化、デジタル/アナログ混載等により、柔軟に多様な設計スタイルに対応できる環境が求められています。

「Ismo」は、このような要求に応えるため、これまでに培ってきた豊富な経験と高い技術力により、当社企業グループが新規に開発した、次世代のレイアウトシステムであります。使い易いマニュアル設計環境と強力な自動設計ツール、検証ツールを高度に統合し、設計者の思い通りの設計環境を実現しております。

会社概要 (平成20年3月31日現在)

商号	株式会社ジエダット (Jedat Inc.)
所在地	〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町6-6
代表者	代表取締役社長 石橋 眞一
営業開始	平成16年2月2日
資本金	760,007,110円
事業内容	電子回路・半導体集積回路・液晶モジュール等設計支援のためのソフトウェア開発・販売及びコンサルテーション
関連会社	株式会社ジエダット・イノベーション (Jedat Innovation Inc.) 福岡県北九州市若松区ひびきの2-5 情報技術高度化センター 績達特軟件 (北京) 有限公司 (Jedat China Software Inc.) 北京市西城区新街口外大街28号B座409-412室 URL http://www.jedat-soft.com.cn 株式会社A-ソリューション (A-Solution Inc.) 東京都中央区日本橋小舟町6-6 URL http://www.a-solutioninc.com
所属団体	社団法人 電子情報技術産業協会 (JEITA) 社団法人 日本半導体ベンチャー協会 (JASVA) 有限責任中間法人 日本エレクトロニクスショー協会 (JESA) 日本EDAベンチャー連絡会 (JEVeC)

役員 (平成20年6月18日現在)

代表取締役社長	石橋 眞一
取締役	増山 雅美 (経営企画部長)
取締役	山城 治
取締役	香月 弘幸 (システム部長)
取締役	藤澤 義麿 ((株)アルゴグラフィックス 代表取締役会長 兼 CEO)
取締役	中村 隆夫 ((株)アルゴグラフィックス 執行役員)
取締役	平田 喜信 (セイコーインスツル(株) 取締役常務執行役員)
常勤監査役	飯村 雄次
監査役	吉田 隆男
監査役	伊藤 俊彦 ((株)アルゴグラフィックス 執行役員)